

熱硬化性樹脂 不飽和ポリエステル材対応端子盤

スマートグリッド市場において太陽光発電機器等では燃え難い材料が求められています。

熱硬化性の不飽和ポリエステル材は、耐熱・耐薬品性・放熱性に優れ、特性劣化が少なく長期に渡り安定した特性が維持可能で、CTI 値 600 にも対応でき太陽光発電機器等に適したフェノール樹脂より付加価値のある材料です。

使用用途：パワーコンディショナ、昇圧装置、蓄電器、急速充電器、燃料電池、電力監視など。

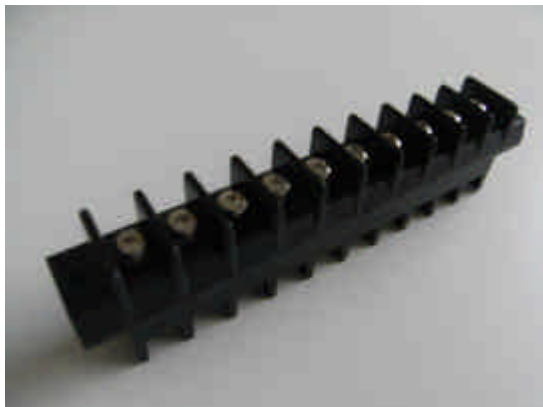
材料物性比較表

項目	不飽和ポリエステル (熱硬化性)(UL94 V-0)	フェノール(熱硬化性) (UL94V-1)	PBT(熱可塑性) (UL94 V-0、ガラス含有)
絶縁抵抗	500V 200M 以上	500V 100M 以上	500V 1000M 以上
使用温度範囲	- 30 ~ +90	- 30 ~ +80	- 30 ~ +90
RTI(使用材料最大温度)	155	150	135
湿度による絶縁性	45% ~ 85%異常なし	45% ~ 85%異常なし	45% ~ 85%異常なし
CTI	クラス0 (CTI = 600)	クラス3 または 4 (一般的にはクラス4)	クラス0 ~ クラス3 (CTI=250 :クラス2)
特性	耐熱に優れ、発火しても形状をとどめることができる。 耐薬品性に優れている。 特性劣化が少なく長期に渡り安定した特性が維持可能。	耐熱に優れ、発火しても形状をとどめることができる。	発火した場合、発火部分は軟化する。
設計上のメリット・デメリット	肉厚が大きく違ってても成形できる。	肉厚が大きく違ってても成形できる。	肉厚を均一にする必要あり
衝撃性	弱い	弱い	強い
環境面	ハロゲンフリー	フェノール・アンモニア含有	臭素系難燃剤
その他	F2050E とF2085NE シリーズで対応可能。	_____	_____

FUJICON **新製品ニュース**

貫通型端子盤のフェノール樹脂製品の F2050E シリーズ F2085NE シリーズで不飽和ポリエステル材での対応が可能です。

F2050E



F2085NE



中継型端子盤のフェノール樹脂製品の F1005 シリーズの 20S,30A,60A,100A でも対応検討中です。

F1005-60A



他のシリーズに於いても対応を検討致しますので、お問合せ下さい。
問合せは、本社 営業部までお願い致します。

【問合せ先】 本社営業部

TEL : 03-3755-5711

FAX : 03-3755-5885

e-mail : info@fujicon-tb.co.jp